

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
7 avril 2005 (07.04.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/030473 A2

(51) Classification internationale des brevets⁷ :
B29C 65/18, B65B 51/30

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/CH2004/000600

(22) Date de dépôt International :
24 septembre 2004 (24.09.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0311533 30 septembre 2003 (30.09.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : **THER-
MOFLUX TECHNOLOGIES SA** [CH/CH]; Chemin de
Galilée 9, CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : **PADOY,
Jean-Claude** [FR/CH]; Chemin des Piccardes, CH-1441
Valeyres-sous-Montagny (CH).

(74) Mandataire : **NITTHARDT, Roland**; Cabinet Roland
Nithardt, Conseils en Propriété Industrielle S.A., Y-Parc /
Rue Galilée 9, CH-1400 Yverdon-les-Bains (CH).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

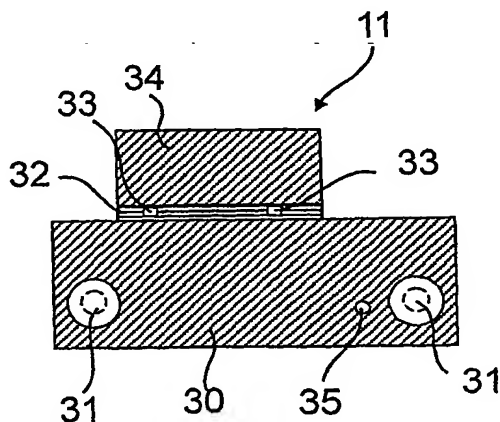
Publiée :

— sans rapport de recherche internationale, sera republiée
dès réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrégia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
abrégiactions" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

(54) Title: HEAT-SEALING METHOD AND DEVICE FOR IMPLEMENTING SAME

(54) Titre : PROCEDE DE THERMOSCELLAGE ET DISPOSITIF POUR LA MISE EN OEUVRE DE CE PROCEDE



(57) Abstract: The invention relates to a device which is used for
the heat-sealing of a thermoplastic synthetic film to a thermoplas-
tic synthetic container. The inventive device comprises at least one
thermal electrode (11) which is made from a material with high ther-
mal conductivity. The aforementioned electrode is equipped with a
metal section (30) having electrical connection terminals (31) at the
ends thereof. A heat flux sensor (32) comprising two electrical con-
nections (33) is also provided, and the lower face thereof is fixed
mechanically to the upper part of the above-mentioned section (30).
In addition, the upper face of said heat flux sensor (32) is fixed to
the lower face of a thermal capacitor (34) which is made from a ma-
terial with high thermal diffusivity and conductivity. Furthermore, a
thermocouple (35) is mounted in a cavity in the metal section (30).

(57) Abrégé : Le dispositif de thermoscellage d'un film de matière
synthétique thermoplastique sur un contenant réalisé en une matière
synthétique thermoplastique, comporte au moins une électrode ther-
mique (11) réalisée en un matériau à forte conductibilité thermique.

Cette électrode est pourvue d'un profilé métallique (30) aux extrémités duquel sont disposées des bornes de connexion électrique (31). Un capteur de flux de chaleur (32), pourvu de deux connexions électriques (33), est fixé mécaniquement par sa face inférieure sur la partie supérieure du profilé (30). La face supérieure de ce capteur de flux de chaleur (32) est fixée à la face inférieure d'une capacité thermique (34) réalisée en un matériau à forte conductivité et diffusivité thermique. Un thermocouple (35) est monté dans une cavité ménagée en le profilé métallique (30).

WO 2005/030473 A2